電子部品の腐食損傷と分析 - 腐食の促進因子とその解析法 -

キーワード 電子部品 腐食 腐食事例 腐食ピット 変色 概要 させる表1の。

電気機器の小型化、部品の集積化、微細化にしたがって、部品の腐食許容が小さくなってきています。また、国際的な部品調達が進められるにつれて、国外での生産プロセスの相違や製造環境の差、輸送が関係する腐食の相談も増加しています。生産工程での汚染の相談も増加しています。生産工程での汚染がある場合はでは、電子部品の腐食の要因、解析プロセスならびに機器分析の実例を紹介します。

腐食とその要因

電子部品が使われる屋内環境における腐食は大気腐食と呼ばれています。空気と接触した金属表面上には、吸着した水の薄い膜が形成されています。品物の表面に吸着イオンやごみなどの汚染物質が存在する場合には、その吸湿作用により低い湿度でも腐食が生じるようになり、またイオン性物質の触媒作用によって腐食反応は清浄な金属に比べて数十から数百倍の速さで進行するようになります。したがって、腐食の原因の追求は腐食を促進

させる表 1 のような要因を明らかにし、これ を取り除くことが対策となります。

腐食の解析プロセス

分析の依頼にあたっては、試料の取り扱い に十分注意を払うことが大切です。また、腐 食された部品の材質、図面、近傍の部品の材 質、その部品の生産工程表、保管場所、使用 環境などをまとめておくことは解析時間の短 縮と分析費用の軽減に有効です。分析に用い る機器は、聞き取り調査ならびに過去の事例 等にもとづき、汚染物質の種類、腐食面積の 大きさ・深さ、装置感度に応じて選択します。 当所では、腐食状況の観察に実体顕微鏡や走 査型電子顕微鏡(SEM)を、表面分析に電子線 マイクロアナライザ(EPMA)、蛍光X線分析 装置(XFS)、X線光電子分光分析(ESCA あるいはXPS)を、腐食生成物の同定にX線 回折(XRD)が、有機汚染物質の場合にはフー リエ変換赤外分光分析装置(FT-IR)、ガス クロ分離型質量分析計(GC-MS)を、表面に 微量存在する無機イオンの検出にイオンクロ マト(IC)、発光分析装置(ICP)等を用いて います。

表1 電子部品の腐食損傷とその要因

発生するトラブル 接点不良、断線、絶縁不良、破壊など腐食形態

ピット、付着物生成、クリープ、デポジット、フレッティング マイグレーション、ウイスカー発生、応力腐食割れ、腐食疲労など

腐食促進物質と発生場所

生産過程 : フラックス、めっき液、洗浄液、エッチング液、溶剤、汗など

塩化物、硝酸塩、硫酸塩、硫化物、有機酸、アルカリなど

輸送、保管:段ボール、プラスチック、接着剤、ゴム、断熱材、潤滑油など

硫化水素NOx、SOx塩化水素 塩素 アミン、アンモニア、有機酸 アルデヒトなど

海塩粒子、ほこりなど

腐食促進要因 湿度、温度、水、熱、異種金属接触など

機器分析の実施例

- 絶縁不良・短絡 -

電気回路の短絡や絶縁不良には、配線間における腐食生成物の成長(クリープ)、溶出金属の再析出(マイグレーション)などが関係しています。スズなどの金属では、ウイスカーなども発生します。スズめっきが腐食されて生成したウイスカーのSEM写真を図1に示します。めっき表面には数μmと細いひげ状の生成物が認められます。その長さは腐食環境が整えば数mm以上に成長することもあります。

- 接点不良 -

EPMAは、走査型電子顕微鏡に蛍光X線を測定する機構を付属した分析装置です。この方法の特長は、試料表面を拡大観察し分析位置を特定できることです。図2に、ニッケルめっき電池用接点の腐食ヒントのEDXスペクトルを示します。腐食個所では塩素のピークが強く現れており、塩化がカイオンによって腐食が促進されたことがカイオンによって腐食が促進されたことがわかります。EPMAでは観察面における元素の分布を測定できるため、腐食状況をより正確に把握することも可能です。

- 変色の例 -

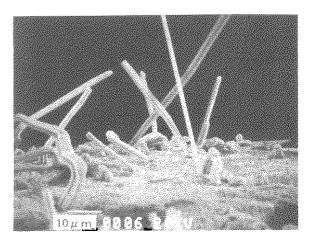


図1 スズめっきのウイスカー(素地 黄銅)

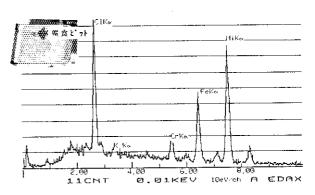


図2 ニッケルめっき端子のEDX分析スペクトル (素地:ステンレス)

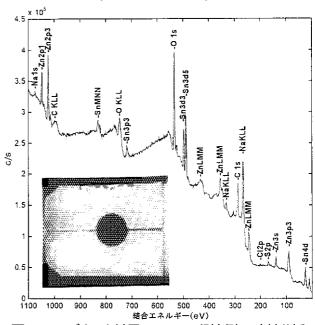


図3 スズめっき端子のESCA測定例 (定性分析)

作成者 評価技術部 表面化学グループ 森河 務 TEL 0725-51-2720 発行日 平成10年1月29日